

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性亦不承擔任何責任。對於準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BASiC Semiconductor Co., Ltd.
深圳基本半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9971)

須予披露交易
建造碳化硅模塊封裝產綫基地

緒言

董事會謹此宣佈，於二零二六年七月二十七日（交易時段後），本公司與承包商就該項目訂立工程總承包合約。據此，承包商同意承接本公司碳化硅模塊封裝產綫基地的工程，合約價格總價為人民幣193,300,000元。

上市規則的涵義

由於有關工程總承包合約項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但均低於25%，工程總承包合約項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，故根據上市規則第14章，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

緒言

董事會謹此宣佈，於二零二六年七月二十七日（交易時段後），本公司與承包商就項目訂立工程總承包合約。據此，承包商同意承接本公司碳化硅模塊封裝產綫基地的工程，總代價為人民幣193,300,000元。

工程總承包合約

日期：於二零二六年七月二十七日（交易時段後）

工程總承包合約的主要條款載列如下。

訂約方： (1) 本公司
(2) 承包商

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承包商及其最終實益擁有人均為本公司及本公司關連人士以外的獨立第三方。

主要事項及工程範圍：涉及建造本公司位於深圳市坪山區丹梓大道與翠景路交匯處西南角的產綫基地，本集團已就此取得國有建設用地使用權，承包商負責項目的施工工程。

工程規模：總建築面積59,357.54平方米，建築2棟，含廠房、辦公及宿舍等配套建築。

代價及付款條款：本公司根據工程總承包合約應付的總代價為人民幣193,300,000元(含稅)(「**合約價格**」)，合約價格為固定總合約價格。

本集團將以內部財務資源及銀行貸款結算代價。

代價須由本公司按下列施工進度向承包商支付：

- (1) 預付款項：合約價格的20%須於簽訂工程總承包合約後支付。
- (2) 進度付款：
 - a. 按施工進度月度支付，每月實際完成並經監理人及發包人審核確認工程量的80%支付工程款，期中支付累計不超過合同總價款的80%；
 - b. 專案工程竣工驗收通過、取得竣工驗收備案回執，且承包人上報完整資料，支付至合同價款的85%；
 - c. 承包人完成工程總承包合約內約定全部工程、辦理工程結算手續及工程總承包合約約定其他條件，由基本半導體支付至合約價格總價的97%。
- (3) 質保金：合約價格的3%須予保留，並須於完成最終竣工驗收及結算後支付。

合約價格的釐定基準：承包商乃是透過公開招標挑選的，其中包括承包商在內的7家投標人提交了投標書供我們考慮，合約價格乃經公開招標以及參考將予承接的工程範圍、項目的預期規模及質量、目前的估計建造成本以及類似性質項目的現行價格經公平磋商後釐定。合約價格為固定總價，除工程總承包合約明確約定的變更外，概不予調整。

工程總承包合約的理由及裨益

董事會（包括獨立非執行董事）認為，(1)訂立項目工程總承包合約將有利於實現本公司的未來營運策略，支撐本公司滿足新能源汽車、智算中心、光伏儲能等日益增長的下遊市場需求，及(2)工程總承包合約的條款及其項下擬進行的交易乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方的資料

(1) 本公司

本公司為根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：9971）。公司是中國第三代半導體功率器件行業的企業，專注於碳化硅功率器件的研發、製造及銷售，整合了碳化硅芯片設計、晶圓製造、模塊封裝及柵極驅動設計與測試能力，產品廣範應用於新能源汽車、智算中心、光伏儲能、軌道交通、智能電網等關鍵領域。

(2) 承包商

承包商為根據中國法律成立的有限公司，是中國建築股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：601668.SH）的全資子公司，總部位於北京，擁有房屋建築施工總承包、市政公用工程施工總承包等6項特級資質，以及建築工程設計甲級、地基基礎、裝飾裝修、鋼結構、橋樑、公路路基等專業資質。

上市規則的涵義

由於有關工程總承包合約項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但均低於25%，工程總承包合約項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，故根據上市規則第14章，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或 「基本半導體」	指	深圳基本半導體股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：9971）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「承包商」	指	中國建築第二工程局有限公司
「董事」	指	本公司董事
「工程總承包 合約」	指	本公司與承包商就項目訂立日期為二零二六年七月二十七日的工程總承包合約（「 工程總承包合約 」）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂及補充）
「中國」	指	中華人民共和國
「項目」	指	工程總承包合約項下擬進行的建設碳化硅模塊封裝產綫基地
「合約價格」	指	本公司根據工程總承包合約應付的總代價
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
 深圳基本半導體股份有限公司
 董事長
 汪之涵博士

香港，二零二六年七月二十八日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事汪之涵博士、和巍巍博士、傅俊寅先生及閔瑞女士；及(ii)獨立非執行董事李居平先生、葉翔先生及王蘇生先生。